

トレックス・セミコンダクター株式会社  
品質保証部

## 成分表

製品名(鉛フリー): XC9223xxxxDR-G  
標準質量: 12 mg

名称	質量(mg)	物質名称	構成比率(ppm)	CAS No.
シリコンチップ	1.370	シリコン	114200	7440-21-3
	-	砒素	<1	7440-38-2
リードパッド	2.831	ニッケル	236000	7440-02-0
	0.223	銀	18600	7440-22-4
	0.042	金	3500	7440-57-5
ダイアタッチ	0.042	エポキシ樹脂	3500	—
	0.036	溶融シリカ	3000	60676-86-0
ボンディングワイヤ	0.272	金	22700	7440-57-5
封止樹脂	6.465	溶融シリカ	538800	60676-86-0
	0.395	エポキシ樹脂	32900	—
	0.323	フェノール樹脂	26900	—

※ 成分組成は、ベンダーからの情報を元に算出しております。機密情報保持の為、開示されない情報があり、全内容を保証するものではありません。

※ 重量、構成比率については、材料等の製造条件によって異なることがあります。

※ CASNo.欄で「-」と表記された物質は、社外秘とさせて頂いております。